

**《单片机原理及接口技术》**

**课程设计说明书**

学生姓名：

学 号：

所在系部：

专业班级：

指导教师：

日 期： 二OXX年X月

（划线内容填写：小3号宋体居中）

**目□□录（要求自动生成）**

（小2号黑体，加粗，居中，并留出上下间距为：段前0.5行，段后0.5行，2倍行距）

（空1行）

**1**□**设计要求**（小4号宋体，行距18磅，一级目录加粗，下同）………………… 1

**2**□**硬件设计**（小4号宋体，行距18磅，一级目录加粗，下同）…………… 2

□□2.1□电路原理图设计 （正文第2章第1条，二级目录） …………… Y

□□2.2□电路引脚分配 （正文第2章第2条，二级目录） …………… Y

**3**□ **软件设计（**正文第3章，一级目录） …………………………………………………………………………………………………… Y

□□3.1□软件流程图 （正文第2章第1条，二级目录） …………… Y

□□3.2□主要功能程序代码分析（正文第2章第2条，二级目录） …………… Y

**4□ 电路仿真**（正文第3章，一级目录） ……………………………………………………………………………………………………………… Y

□□4.1□电路仿真过程 （正文第2章第1条，二级目录） …………… Y

□□3.2□电路仿真结果 （正文第2章第2条，二级目录） …………… Y

**5□ 电路焊接**（正文第3章，一级目录） ……………………………………………………………………………………………………………… Y

□□4.1□电路焊接过程 （正文第2章第1条，二级目录） …………… Y

□□3.2□电路焊接注意事项 （正文第2章第2条，二级目录） …………… Y

**6□ 系统调试**（正文第3章，一级目录） …………………………………………………………………………………………………… Y

□□6.1□遇到的问题及解决方法 （正文第2章第1条，二级目录） …………… Y

**7□ 总结**（正文第3章，一级目录） …………………………………………………………………………………………………… Y

**8．附录：实物图（彩图）、仿真电路图、原理图、PCB图、**源程序；元器件清单；

**1**□**设计要求**

（可作为正文第1章标题，小2号黑体，加粗，居中，并留出上下间距为：段前0.5行，段后0.5行，2倍行距）

□□×××××××××（小4号宋体，1.5倍行距。下同）×××××××××××××××××××[[1]](#footnote-1)××…………

1．1□××××（作为正文2级标题，用小3号黑体）

□□×××××××（小4号宋体，1.5倍行距）××××××…………

1.1.1□××××（作为正文3级标题，用4号黑体，不加粗）

□□××××××[[2]](#footnote-2)×××（小4号宋体，1.5倍行距）×××××××××××××××××××××××××××…………

（正文各1级标题之间需要另新起一页！）（空1行）

**2**□**×××××××**

（作为正文第2章标题，小2号黑体，加粗，居中，并留出上下间距为：段前0.5行，段后0.5行，2倍行距）

□□×××××××××（小4号宋体，1.5倍行距）×××××××××××××××××××××××××××××××××××…………

表1 ×××××××

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验号 | 温度/0C | 摩尔比1） | 催化剂2）/g | 反应时间/h | 产量/kg |
| 1  2 |  |  |  |  |  |

1）………

2）………

注：1．正文中**表格**与**插图**的字体一律用5号宋体；

2. 引用参考文献的内容请予以注明；

3．正文各页的格式请以此页为标准复制。

1. 对论文正文中某一特定内容的进一步解释或补充说明性的注释，置于本页地脚，前面用圈码标识。(小5号宋体，单倍行距，下同)。 [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)